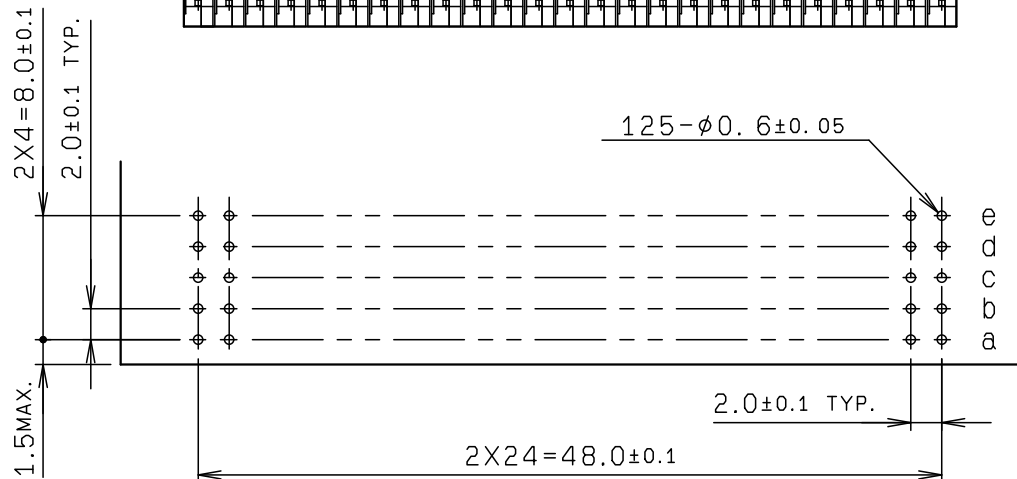
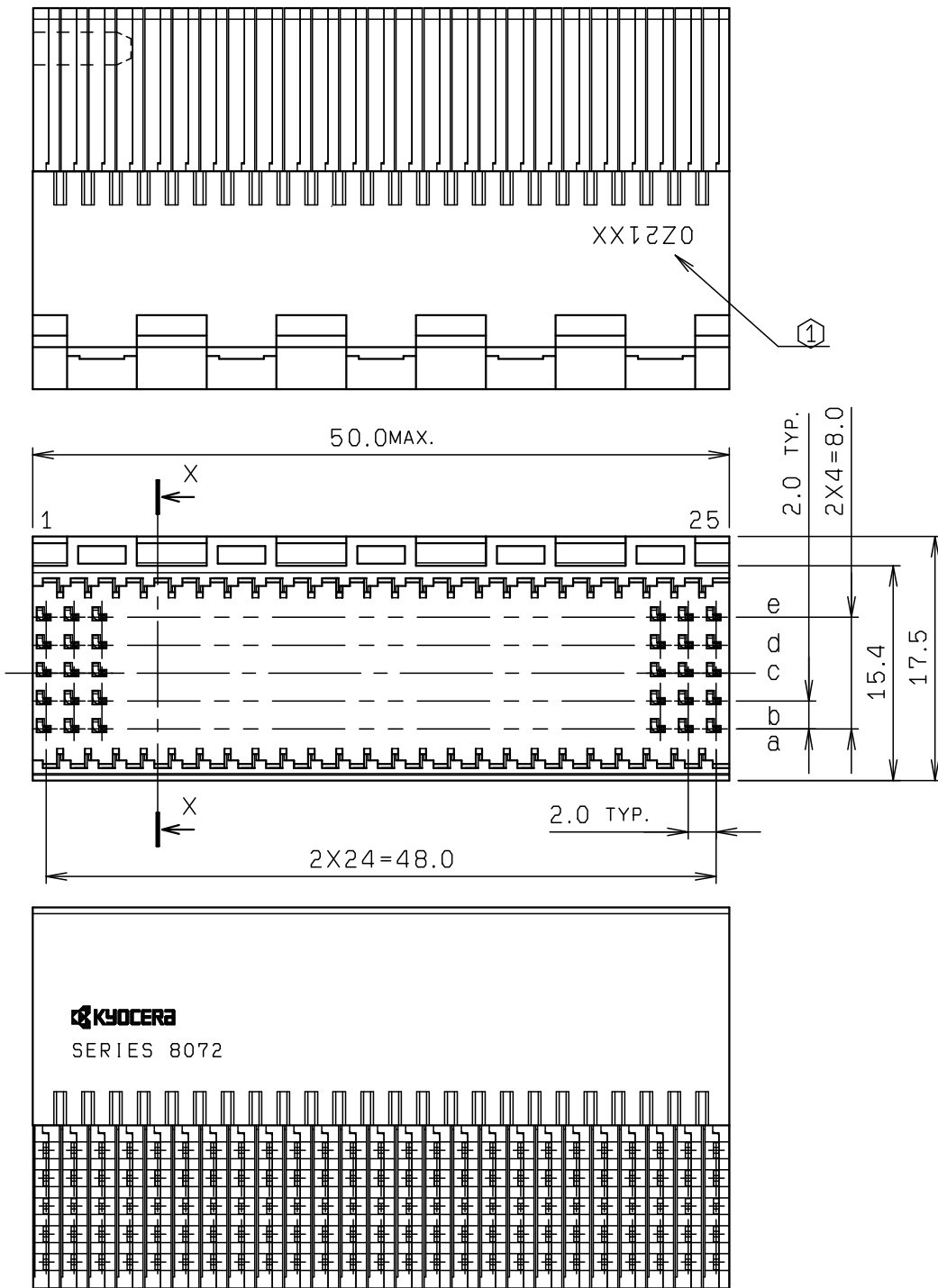
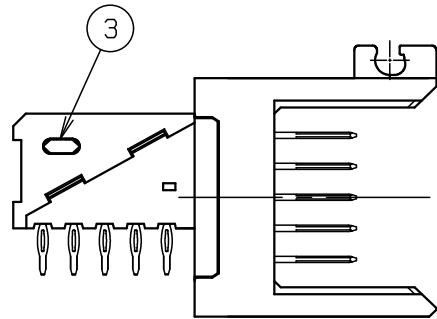
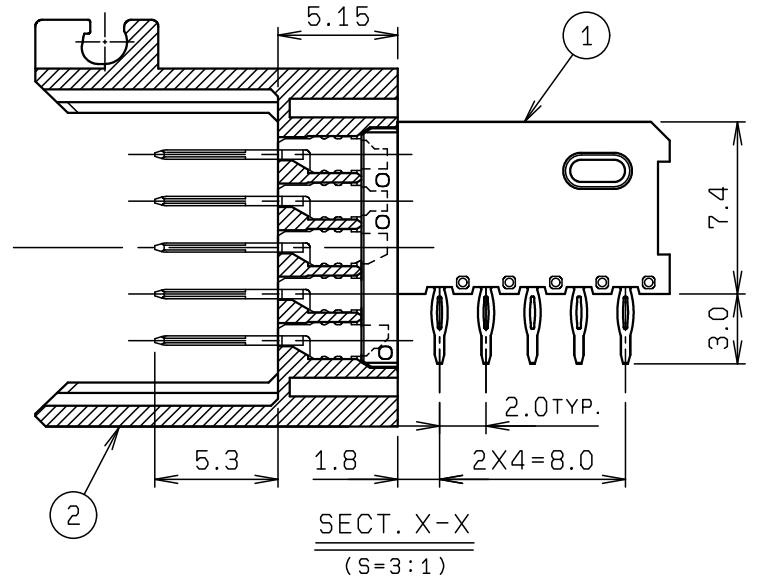
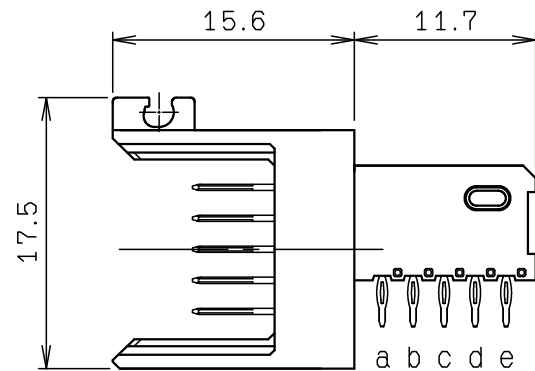


ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

推奨基板取付け寸法 (部品面)
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONTACT MODULE		25	PHOS-BRONZE		
2	PLUG INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY
3	JOINT BAR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY



型番
P/N
17 8072 125 200 XXX +
接頭
PREFIX
17:プラグ/プレスフィット
PLUG PRESS FIT TYPE
極数
NO. OF POS.
125:125POS.
バリエーション
VARIATION
200:ポラライジングキー無し(ラッチ付きタイプ),
ショートピン
WITHOUT POLARIZING KEY
(WITH LATCH TYPE), SHORT PIN
めっき
PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
518		Au:0.1μm MIN.	
519		Au:0.38μm MIN.	
515	Ni:1.2~3μm	Pd/Ni:0.65μm MIN. Au:0.1μm MIN.	AU FLASH
517		Au:0.76μm MIN.	
835	Ni:1.2μmMIN.	Pd/Ni:0.4μmMIN. Au 0.03μmMIN.	無鉛Sn:1.2μmMIN.

+ :Pb-FREE

注記
NOTE

- ① 製造ロット番号表示 LOT. NO.
0Z21XX
製造年 YEAR
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE
2. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:
t=1.4~4.2mm
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:
φ0.7±0.025mm
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
25~50μm
(はんだめっき Sn-Pb PLATING:4~10μm)
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:
φ0.6±0.05mm

TOLERANCE / 一般公差(S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN22331	2022/06/10	T. OTANI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
X <10 ±0.2 10 ≤ X <30 ±0.25 30 ≤ X ±0.3		201-03-471		A	DCN-629	2012/08/01	N. AKA		T. MORI
ANGLE / 角度 ±3°		UNIT mm	ANGLE 3RD	O	EDN-374	2007/05/17	M. YOSHIDA		T. MORI
SCALE 2:1		DATE 2007/05/17		PART NAME / 品名 SERIE 8072 PLUG ASSY RA PRESS FIT WITHOUT POLARIZING KEY (STD PIN)					
DRAWN LI	DESIGNED M. YOSHIDA	CHECKED	APPROVED T. MORI	PART NO. / 型番 17 8072 125 200 XXX +					
DWG NO. / 図番 BJS 8072034				SHEET REV 1/1 B					

KYOCERA